

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА,  
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

**ФЕЕ :: 2013**

**МАТЕРІАЛИ  
та програма**

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

(Суми, 22-27 квітня 2013 року)

Суми  
Сумський державний університет  
2013

## Дослідження ємності конденсаторів поверхневого монтажу під час згинання друкованої плати

Кириченко М.В., студ.; Чапний Т.М., студ.  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут», м. Київ

Як і більшість інших видів пошкоджень поверхневого монтажу частка в них керамічних конденсаторів була значного зменшена на протяжі останніх років, тріщини через напруги від згинання плати стали відомими. Тріщини керамічних конденсаторів можуть призводити до передчасного пошкодження всього приладу.

Метою даної роботи є дослідження впливу згинання плати на ємність конденсаторів поверхневого монтажу та попередження тріщин.

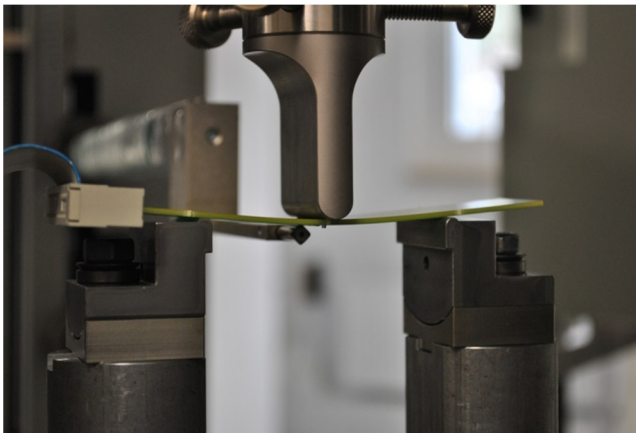


Рисунок 1 – Розміщення плати під час дослідження ємності

Для даного дослідження був застосований трохточковий метод згинання плати.

Експериментальним шляхом було встановлено, що під час згинання дослідного зразка ємність конденсаторів поверхневого монтажу зменшується.

Керівник: Денбновецький С.В., проф.